Analyst 김중배 kjb6551@hmsec.com

엠케이전자 (033160)

1분기 실적 서프라이즈. 그러나 아직 SOCAMM은 시작도 안했다

BUY **TP 40,000원**

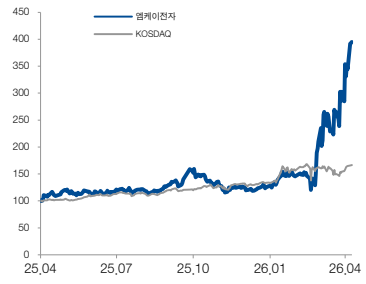
현재주가 (4/22)	26,900원
상승여력	48.7%
시가총액	630십억원
발행주식수	24,054천주
자본금/액면가	11십억원/500원
52주 최고가/최저가	26,900원/7,340원
일평균 거래대금 (60일)	20십억원
외국인 지분율	8.39%
주요주주 지분율	
오션비홀딩스 외 2 인	33.41%

주가상승률	1M	3M	6M
절대주가(%)	48.9	195.3	168.2
상대주가(%p)	46.4	142.6	99.6

* K-IFRS 별도 기준

(단위: 원)	EPS(26F)	EPS(27F)	T/P
Before	797	1,716	21,500
After	1,194	1,801	40,000
Consensus	797	1,716	21,500
Cons. 차이	49.8	5.0	86.0

최근 12개월 주가수익률



자료: FnGuide, 현대차증권

투자포인트 및 결론

- AI Server향 LPDDR 및 Memory 수요가 지속적으로 확대됨에 따라 동사의 와이어본딩 수요 역시 강세를 보이고 있음. 이외에도 중국법인의 와이어본딩 수요가 국내보다 더욱 강력하게 지속. 신사업인 Pd Alloy 역시 Mix를 개선하는 데 크게 기여. **다만, 1분기의 호실적은 SOCAMM이 반영되기 이전이며, 2분기 말 혹은 3분기부터 온기로 반영될 것을 감안한다면 향후의 실적 눈높이는 더욱 높아질 수밖에 없음.** 투자의견 BUY, 목표주가 40,000원으로 기존 추정치 대비 86% 상향(기존 목표주가는 반도체 후공정 사업을 영위하는 국내 법인(별도)와 중국 쿤산 법인의 실적은 과거 Wire-Bonding의 수요 전성기였던 2009-2011년 Target P/E의 상단 평균인 13.6배를 적용 후 SOTP로 목표주가 산출). IT H/W 중소형주 내 Top-Pick 제시

주요이슈 및 실적전망

- **1Q26 별도 기준 매출액은 2,887억원(YoY +86%), 영업이익은 83억원(YoY +127%, OPM +2.9%)을 예상.** 연결 기준 매출액은 4,724억원(YoY +67%), 영업이익은 245억원(YoY 흑자전환, OPM +5.2%)을 예상하는데, 이 중 한국토지신탁과 동부엔텍을 제외한 **반도체 부분 영업이익은 기존 추정치 대비 약 33% 상회할 것으로 예상**되며, 높은 기대치 대비 더 빠른 속도로 업황이 흘러가고 있음을 증명할 것
- 국내 법인(별도)의 Gold Bonding Wire 수요가 매우 강력하게 유지되고 있음. **1Q26를 두고 봤을 때 4Q25 평월 대비 약 15-20% 이상의 수요가 반영**되고 있으며 Gold의 원가상승분을 고려했을 때 **매출액은 QoQ 20% 이상 증가**할 것으로 보임. 여기에 더해 Pd Alloy의 본격적인 출하로 인해 수익성 역시 소폭 개선될 것으로 보임. 2분기 중 4월 금 와이어본딩 역시 1분기의 양호한 흐름 대비 더욱 양호한 수준으로 출하 중. **MoM으로 약 10% 이상 출고량이 증가할 것으로 보이고 이 역시 SOCAMM 물량은 아직 반영이 안된 수준. SOCAMM2로 인한 LPDDR5x의 와이어본딩 수요는 이르면 5월부터 반영될 것으로 예상되고, 초기에는 물량이 그리 많지 않겠으나 Vera의 침투율이 빠르게 확대되며 하반기부터는 SOCAMM2로 인한 LPDDR5x의 수요가 급증할 것으로 예상됨. Pd Alloy 역시 1분기에도 양호한 판매를 기록하였지만, 2분기에는 QoQ +30-40% 성장할 것으로 예상되고, 하반기에도 QoQ +20-30%의 성장세가 지속될 것으로 예상됨.** Gold Wire의 수요가 지속적으로 증가할수록 수익성은 더욱 개선되고, Pd Alloy의 빠른 성장이 결국 Mix를 주도하며 강력한 실적 성장이 예상됨
- **국내 법인의 호실적 이면에는 중국법인의 강력한 수요가 있음. 중국 법인은 실제로 물량 기준으로 국내 법인 대비 강한 수요 상황을 보이고 있으며, 4Q25 대비 약 15% 수준의 Q 증가가 있던 것으로 추정됨.** 이는 중국 내수 OSAT, Foundry 업체들의 강한 Bonding Wire 수요에 기인함. 여기에 더해 Copper 기반의 고마진 Bonding Wire의 출하 확대에 따른 Mix 개선으로 중국법인의 수익성은 전분기 대비 큰 폭으로 개선될 것. **향후에도 이러한 높은 수익성이 지속될 것으로 예상. 중국법인은 국내 법인과 더불어 연결 실적의 이익 개선을 주도할 것으로 보임**

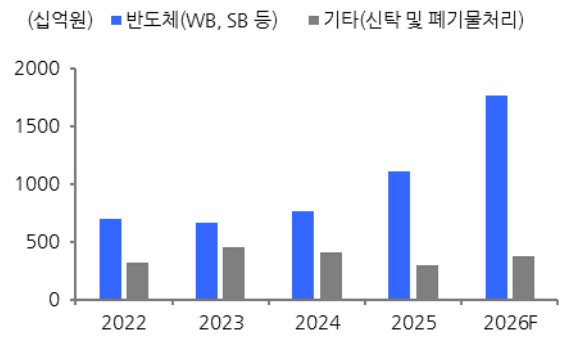
주가전망 및 Valuation

- **Wire Bonding은 Memory Super-Cycle 내 구조적인 성장과 맞물려 직접적으로 수혜가 예상되며, 이러한 부분은 이미 단기 실적에서 증명이 되고 있다고 판단됨.** 여기에 더해 신사업인 Pd Alloy와 Paste 사업은 향후에 동사의 낮은 수익성을 확대할 수 있어 결국 외형 성장뿐 아니라 체질 개선까지 동시에 이뤄지고 있음. 반도체 부분에서의 이익 추정치 상향 및 Multiple을 기존 13.6배에서 18.5배(Wire Bonding 수요 고점인 '09-'11 FY0 P/E 상단)로 상향 조정하였음. 나머지 연결회사를 포함하여 SOTP Valuation으로 목표주가 40,000원 산출

구분	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EBITDA (십억원)	EPS (원)	증감율 (%)	P/E (배)	P/B (배)	EV/EBITDA (배)	ROE (%)	배당수익률 (%)
2024	556	10	-5	15	-224	적전	N/A	1.1	25.2	-3.6	1.5
2025	795	17	5	21	245	흑전	34.3	1.3	20.2	3.9	1.4
2026F	1,369	40	28	44	1,194	387.6	22.4	3.8	18.8	18.1	0.4
2027F	1,866	59	43	63	1,801	50.8	14.9	3.1	12.1	22.8	0.4
2028F	2,361	80	63	84	2,633	46.2	10.2	2.4	6.7	26.3	0.4

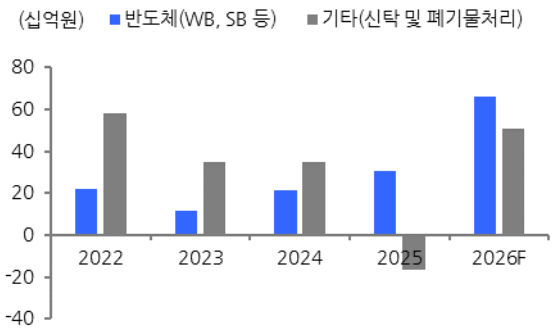
* K-IFRS 별도 기준

<그림1> 엠케이전자 사업부별 매출액 추이



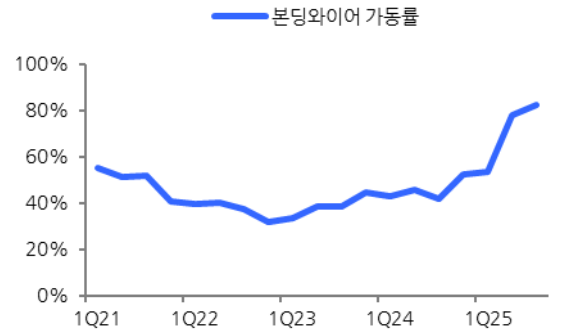
자료: 엠케이전자, 현대차증권

<그림2> 엠케이전자 사업부별 영업이익 추이



자료: 엠케이전자, 현대차증권

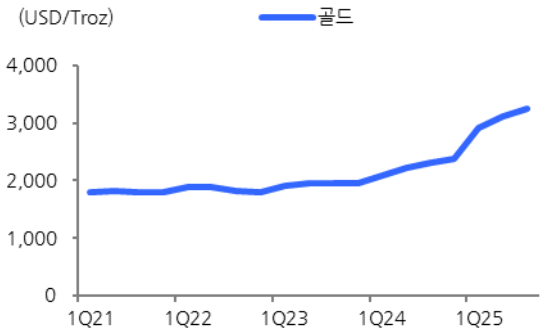
<그림3> 본딩와이어 가동률



주: 생산실적/생산능력으로 계산. 생산실적과 생산능력은 모두 금액 기준

자료: 엠케이전자, 현대차증권

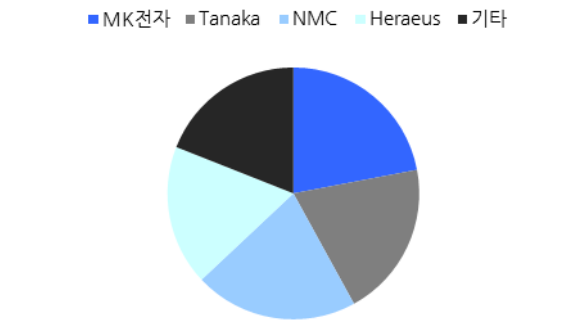
<그림4> Gold Wire 원재료



주: 원재료 가격은 평균 구매가격 기준

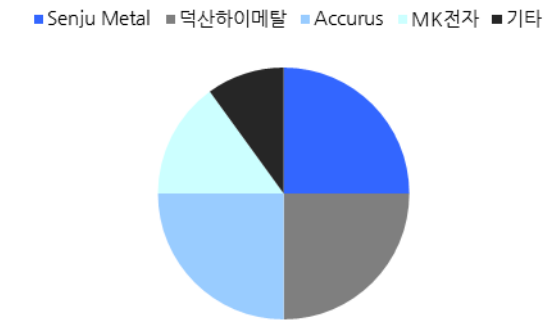
자료: 엠케이전자, 현대차증권

<그림5> 글로벌 본딩와이어 점유율



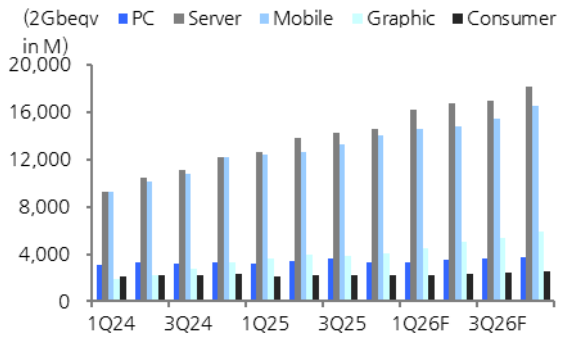
자료: 엠케이전자, 현대차증권

<그림6> 글로벌 솔더볼 점유율



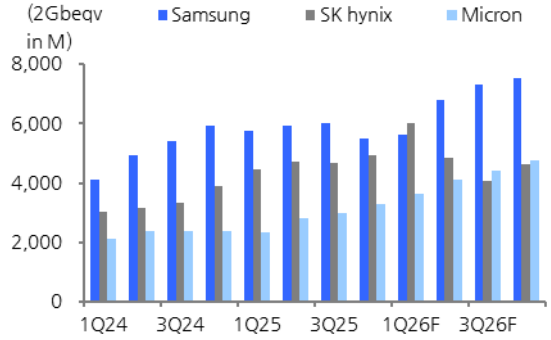
자료: 엠케이전자, 현대차증권

<그림7> 응용처별 DRAM 출하량



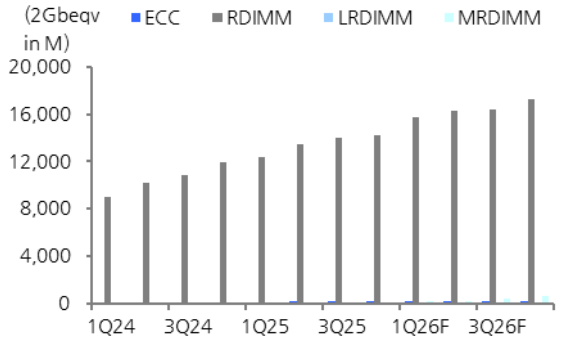
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림8> Memory 3사 Server DRAM 출하량



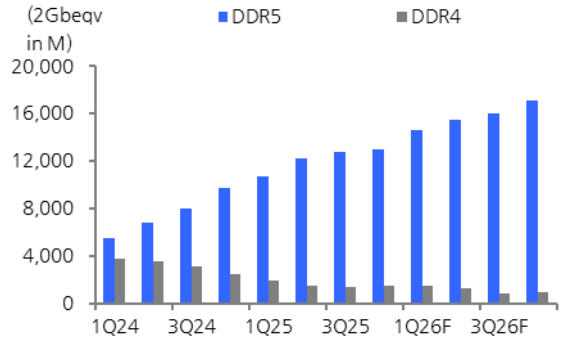
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림9> 패키지별 Server DRAM 출하량



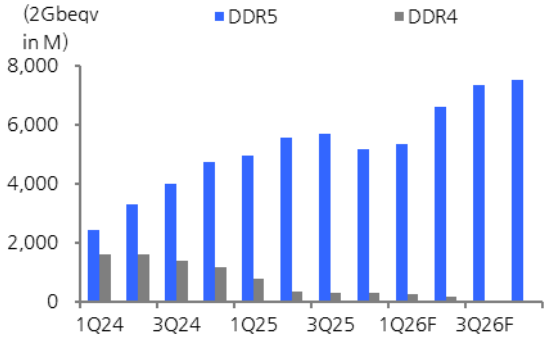
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림10> 제품별 Server DRAM 출하량



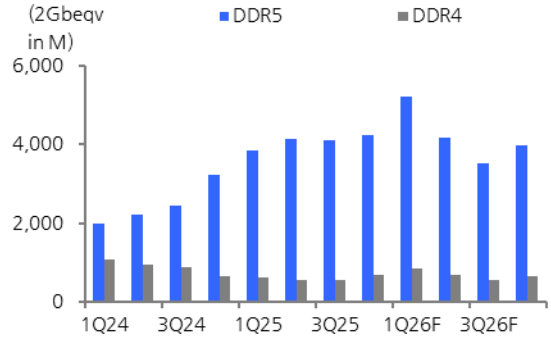
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림11> 삼성전자 Server DRAM 출하량



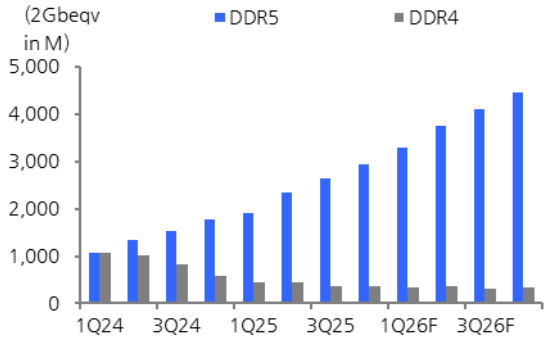
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림12> SK하이닉스 Server DRAM 출하량



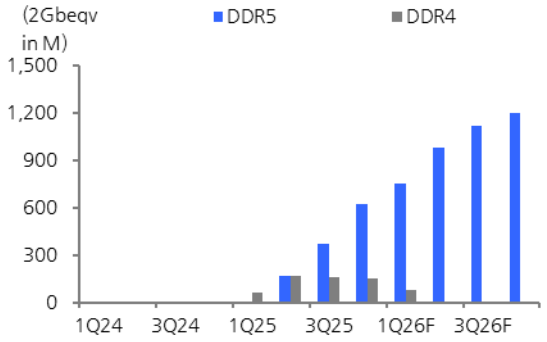
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림13> Micron Server DRAM 출하량



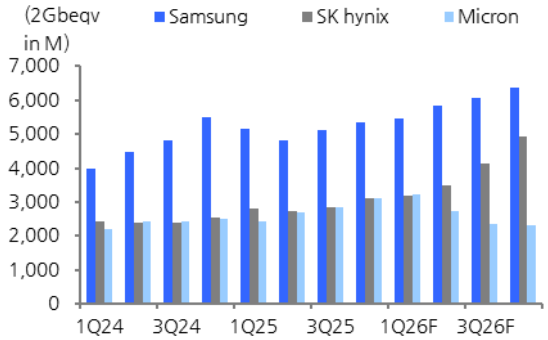
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림14> CXMT Server DRAM 출하량



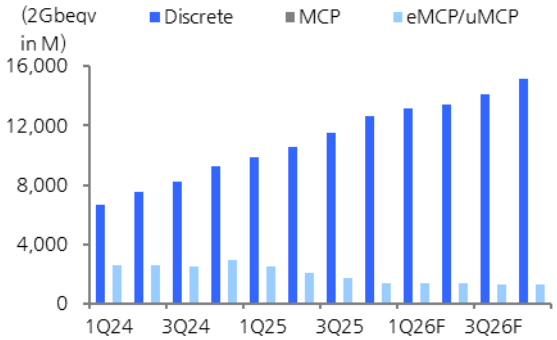
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림15> Memory 3사 Mobile DRAM 출하량



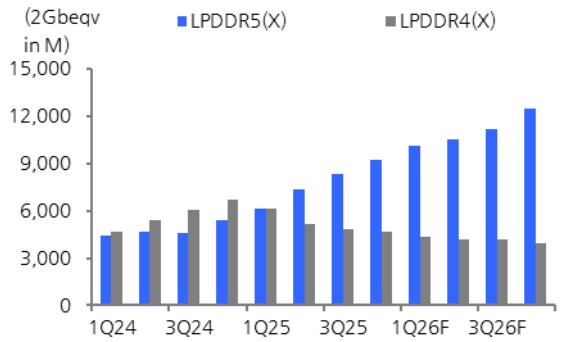
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림16> 패키지별 Mobile DRAM 출하량



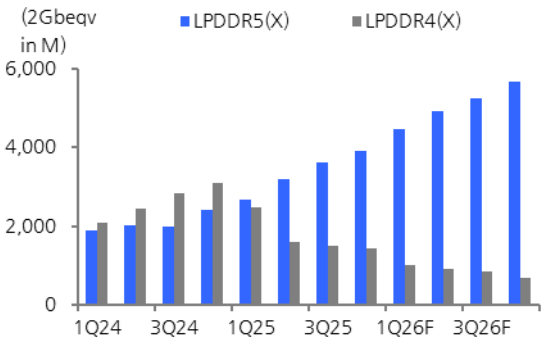
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림17> 제품별 Mobile DRAM 출하량



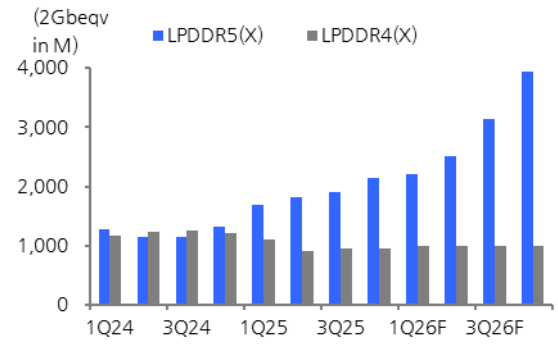
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림18> 삼성전자 Mobile DRAM 출하량



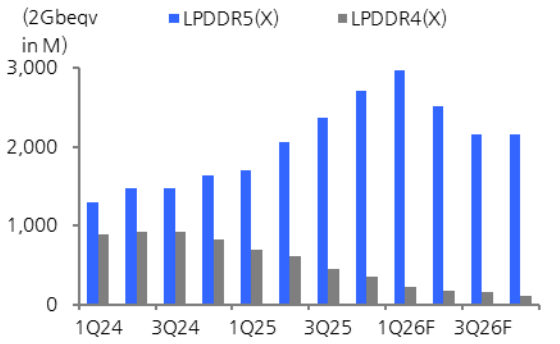
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림19> SK하이닉스 Mobile DRAM 출하량



자료: Trendforce, 현대차증권

<그림20> Micron Mobile DRAM 출하량



자료: Trendforce, 현대차증권

<표1> 응용처별 메모리 규모 비교

구분	Smartphone	PC	AI Server
DRAM	8~16GB	16~32GB	**1~2TB**
NAND	256GB~1TB	512GB~2TB	**8~30TB**
HBM	없음	없음	**0.6~1.5TB**
메모리 원가 비중	~25%	~30%	**40~60%**

자료: 현대차증권

〈표2〉 응용처별 패키징 방식 비교

적용 영역	연결 방식	내용	Wire Bonding의 현재 위치
저핀수 아날로그 IC, PMIC, MCU, EEPROM, 인터페이스 IC	Wire Bonding	핀 수가 많지 않고 원가 민감도가 높으며, 리드프레임/QFN/DFN/QFP 계열 패키지가 경제적	주력 적용처
자동차 body / zone / lighting / sensor interface / SBC	Wire Bonding 중심	장수명·고신뢰성·원가 경쟁력이 중요하고, 중저핀 mixed-signal 칩이 많음	매우 견조
RF 모듈, connectivity module, 일부 SiP	Wire Bonding + 일부 Flip-Chip 혼합	모듈 내부에서 여러 die/passive를 저비용으로 연결하기 좋고, 필요한 곳만 flip-chip을 쓰는 혼합 구조가 효율적	여전히 중요
모바일 AP 주변부 전력/제어칩	Wire Bonding + 일부 FCOL/HotRod	일반 제어칩은 wire bond면 충분하지만, 고속 전력 경로나 EMI가 중요한 칩은 bond wire 제거가 유리	일부 대체 진행
고성능 AP, GPU, 서버 CPU, 네트워크 ASIC	Flip-Chip	I/O 수, 전기적 성능, 열 특성 요구가 높아 wire bond의 주변부 배선 구조로는 한계가 큼	대부분 대체됨
HBM, 2.5D/3D, AI 가속기 패키지	TCB / Hybrid Bonding / Advanced Packaging	초고대역폭, 초미세 피치, 짧은 interconnect가 필요	사실상 비주력
전력반도체 discrete / module	Heavy Wire / Ribbon / Clip / 일부 Wirebond-free 공존	전통적으로 wire가 강했지만, 고전력·고열·고사이클 환경에서는 clip·wirebond-free가 유리	공존 구간
산업용 파워, 충전기, 서버 전원, 중저전력 모듈	Wire / Ribbon / Clip 혼합	최첨단 traction inverter만큼의 extreme spec은 아니어서 기존 wire 계열도 경쟁력 있음	여전히 크다

자료: 현대차증권

〈표3〉 Memory 아키텍처 간 비교(DIMM vs HBM vs CAMM)

구분	DIMM / RDIMM	HBM	SoCAMM
위치	메인보드 슬롯	칩 패키지 내부	SoC 인접
대역폭	중간	매우 높음	높음 (HBM보다는 낮을 수 있음)
전력 효율	보통	매우 우수	우수
확장/교체	매우 용이	불가	제한적이나 가능
비용 구조	낮음	매우 높음	중간
주요 용도	범용 Server	AI GPU	AI SoC, 가속기, 엣지

자료: 현대차증권

〈표4〉 SCAMM1 vs SOCAMM2 스펙 비교

구분	SOCAMM1	SOCAMM2
도입 시점	2023~2024	2025~
주도 업체	NVIDIA(초기 주도), 일부 CSP	NVIDIA 차세대 플랫폼 중심
메모리 규격	LPDDR5 / LPDDR5X	LPDDR5X(고속 bin) 또는 LPDDR6(예정)
인터페이스	저전력 병렬 인터페이스	인터페이스 고속화 및 채널 확장
대역폭	SOCAMM2 대비 낮음	SOCAMM1 대비 대폭 증가
모듈 용량	수십 GB 수준	64~128GB 이상 확대
전력효율	우수	동일 전력 대비 성능 향상
적용 플랫폼	Hopper 일부 구성, Grace Hopper 초기	Blackwell(B100/B200), 차세대 Grace
역할 포지션	HBM 보조(보완 메모리)	HBM과의 계층적 메모리 구조의 핵심

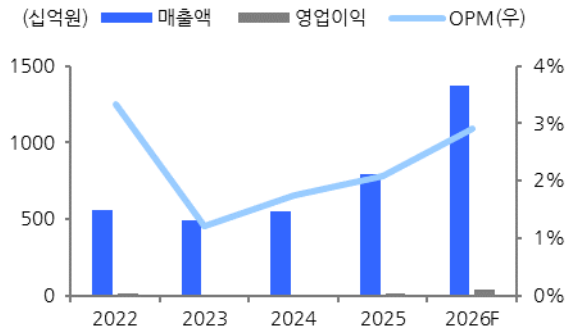
자료: 현대차증권

〈표5〉 Memory 3사 SOCAMM2 스펙 비교

	삼성전자	SK하이닉스
모듈 용량	192GB	192GB
동작 속도	8.5Gbps	7.5-9.6Gbps
메모리 규격	LPDDR5X	LPDDR5X
I/O 핀수	694개	694개

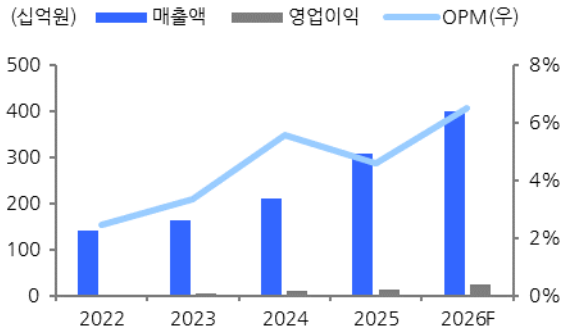
자료: 현대차증권

〈그림21〉 엠케이전자 국내법인 실적 추이



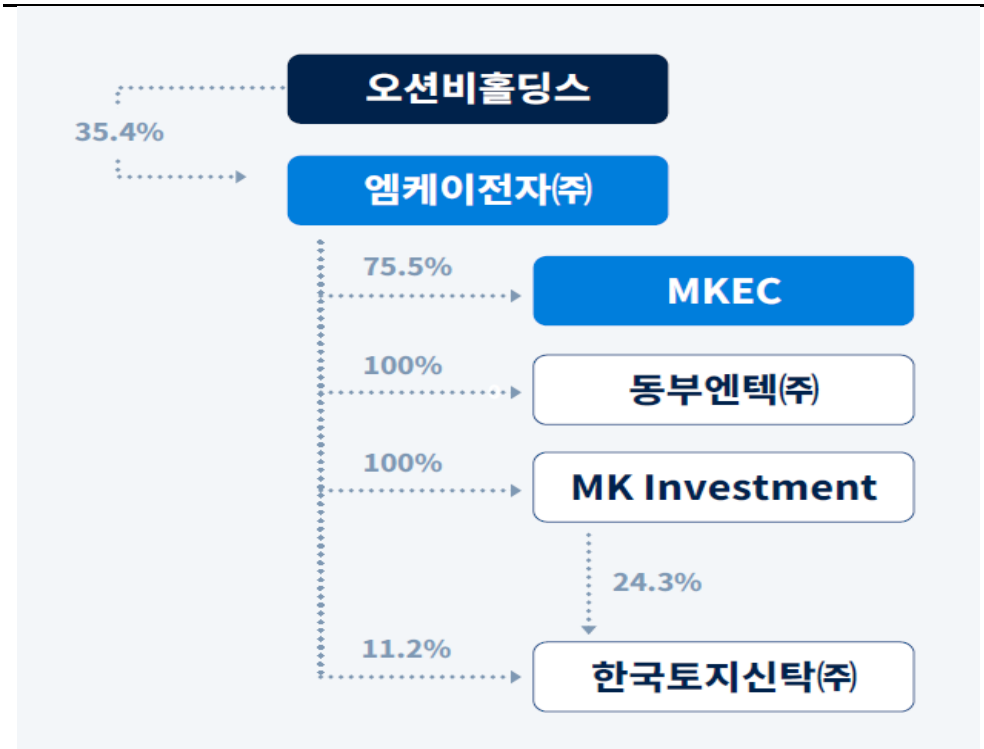
자료: 엠케이전자, 현대차증권

〈그림22〉 엠케이전자 중국법인 실적 추이



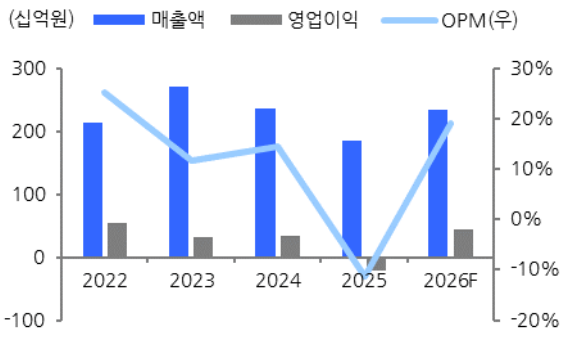
자료: 엠케이전자, 현대차증권

〈그림23〉 엠케이전자 지배구조



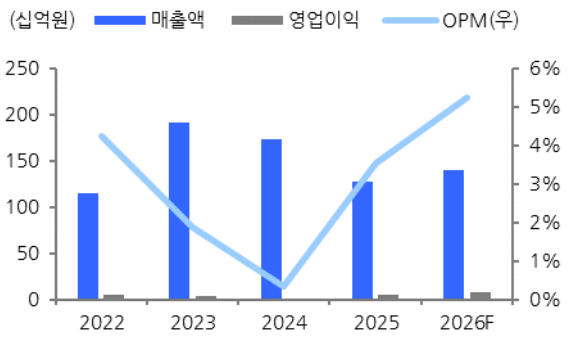
자료: 엠케이전자, 현대차증권

〈그림24〉 한국토지신탁 연간 실적 추이



자료: 엠케이전자, 현대차증권

〈그림25〉 동부엔텍 연간 실적 추이



자료: 엠케이전자, 현대차증권

〈표6〉 엠케이전자 분기별 실적 추이

(단위: 십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26F	2Q26F	3Q26F	4Q26F	2024	2025	2026F
매출액(연결)	**283.7**	**336.1**	**376.9**	**407.1**	**472.4**	**528.6**	**551.6**	**591.8**	**1,170.6**	**1,403.8**	**2,144.4**
YoY	*4.3%*	*13.9%*	*40.7%*	*21.3%*	*66.5%*	*57.3%*	*46.3%*	*45.4%*	*4.8%*	*19.9%*	*52.8%*
QoQ	*-15.5%*	*18.5%*	*12.1%*	*8.0%*	*16.0%*	*11.9%*	*4.3%*	*7.3%*			
반도체	**218.4**	**262.8**	**307.2**	**315.5**	**385.4**	**432.1**	**466.5**	**486.8**	**768.5**	**1,103.9**	**1,771.0**
국내법인(별도)	155.3	184.2	223.1	232.8	288.7	332.0	365.2	383.5	**556.0**	**795.4**	**1,369.5**
중국법인(MKEC)	63.1	78.6	84.1	82.7	96.7	100.1	101.3	103.3	**212.5**	**308.5**	**401.5**
기타	**65.2**	**73.4**	**69.8**	**91.6**	**86.9**	**96.5**	**85.0**	**105.0**	**402.1**	**299.9**	**373.4**
매출원가(연결)	**277.6**	**316.1**	**375.5**	**387.4**	**440.3**	**484.3**	**507.6**	**560.9**	**1,084.9**	**1,356.6**	**1,993.1**
(%)	*97.9%*	*94.0%*	*99.6%*	*95.2%*	*93.2%*	*91.6%*	*92.0%*	*94.8%*	*92.7%*	*96.6%*	*92.9%*
매출총이익(연결)	**6.0**	**20.1**	**1.5**	**19.7**	**32.1**	**44.3**	**43.9**	**31.0**	**85.7**	**47.3**	**151.3**
GPM	*2.1%*	*6.0%*	*0.4%*	*4.8%*	*6.8%*	*8.4%*	*8.0%*	*5.2%*	*7.3%*	*3.4%*	*7.1%*
판매관리비(연결)	**7.2**	**8.3**	**7.9**	**9.5**	**7.6**	**8.7**	**8.3**	**9.9**	**29.6**	**32.9**	**34.5**
(%)	*2.5%*	*2.5%*	*2.1%*	*2.3%*	*1.6%*	*1.6%*	*1.5%*	*1.7%*	*2.5%*	*2.3%*	*1.6%*
영업이익(연결)	**-1.2**	**11.8**	**-6.4**	**10.2**	**24.5**	**35.6**	**35.6**	**21.1**	**56.1**	**14.4**	**116.8**
YoY	*-113.2%*	*-44.6%*	*-232.0%*	*-51.9%*	*-2229.8%*	*202.7%*	*-653.0%*	*106.0%*	*20.7%*	*-74.3%*	*711.0%*
OPM	*-0.4%*	*3.5%*	*-1.7%*	*2.5%*	*5.2%*	*6.7%*	*6.5%*	*3.6%*	*4.8%*	*1.0%*	*5.4%*
반도체	**6.6**	**5.1**	**8.9**	**10.2**	**14.6**	**16.1**	**17.3**	**17.9**	**21.6**	**30.8**	**65.9**
국내법인(별도)	3.7	1.5	5.0	6.4	8.3	9.6	10.7	11.2	**9.8**	**16.6**	**39.8**
중국법인(MKEC)	2.9	3.6	3.9	3.8	6.3	6.5	6.6	6.7	**11.8**	**14.2**	**26.1**
기타	**-7.7**	**6.6**	**-15.4**	**0.0**	**9.9**	**19.5**	**18.3**	**3.2**	**34.5**	**-16.4**	**50.9**

자료: 현대차증권

<표7> 엠케이전자 Valuation 및 목표주가 산출

구분	내용	비고
엠케이전자 별도(①=axb) (억원)	**5,243**	
26F 별도 순이익(a) (십억원)	28	
Target P/E(b) (x)	18.5	과거 Wire-Bonding의 수요 전성기였던 2009년-2011년 P/E 최상단 Multiple
MKEC(중국 법인)(②) (억원)	**2,734**	별도 법인과 동일한 Multiple 적용 지분율 75.5% 반영
한국토지신탁(③) (억원)	**684**	현재 시가총액 3,853억원(4/22) 기준 지분율 35.5% 및 NAV 할인 50%
동부엔텍(④) (억원)	**200**	환경에너지 사업, 순이익 40억원 x Peer Multiple 5배 적용
시총 Total (십억원) (① +②+③+④)	886	
유통주식수 (주)	22,305,008	
목표주가 (원)	40,000	
현재주가 (원)	26,900	4/22 종가 기준
Upside Potential(%)	48.7	

자료: 현대차증권

(단위: 십억원)

포괄손익계산서	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**556**	**795**	**1,369**	**1,866**	**2,361**
증가율 (%)	12.1	43.1	72.2	36.3	26.5
매출원가	**532**	**764**	**1,315**	**1,792**	**2,264**
매출원가율 (%)	95.7	96.0	96.0	96.0	95.9
매출총이익	**24**	**32**	**55**	**75**	**97**
매출이익률 (%)	4.3	4.0	4.0	4.0	4.1
증가율 (%)	34.1	33.2	72.8	35.8	30.0
판매관리비	**14**	**15**	**15**	**16**	**17**
판관비율(%)	2.5	1.9	1.1	0.9	0.7
EBITDA	**15**	**21**	**44**	**63**	**84**
EBITDA 이익률 (%)	2.7	2.7	3.2	3.4	3.5
증가율 (%)	34.2	45.3	106.4	41.5	33.8
영업이익	**10**	**17**	**40**	**59**	**80**
영업이익률 (%)	1.8	2.1	2.9	3.1	3.4
증가율 (%)	62.0	71.4	138.2	47.5	36.8
영업외손익	**-16**	**-9**	**-5**	**-5**	**-1**
금융수익	30	31	9	10	13
금융비용	47	40	14	14	15
기타영업외손익	1	0	0	0	0
종속/관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	**-6**	**8**	**35**	**54**	**79**
세전계속사업이익률	-1.1	1.0	2.5	2.9	3.4
증가율 (%)	적전	흑전	335.9	56.6	46.2
법인세비용	-1	2	6	11	16
계속사업이익	-5	5	28	43	63
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	**-5**	**5**	**28**	**43**	**63**
당기순이익률 (%)	-0.9	0.7	2.1	2.3	2.7
증가율 (%)	적전	흑전	421.9	52.8	46.2
지배주주지분 순이익	-5	5	28	43	63
비지배주주지분 순이익	0	0	0	0	0
기타포괄이익	11	1	0	0	0
총포괄이익	6	7	28	43	63

(단위: 십억원)

재무상태표	2024	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	**161**	**239**	**311**	**394**	**651**
현금성자산	5	9	49	126	344
단기투자자산	17	16	16	16	0
매출채권	78	114	139	116	141
재고자산	55	94	96	123	149
기타유동자산	6	6	10	14	17
비유동자산	**236**	**236**	**232**	**229**	**65**
유형자산	67	65	61	57	54
무형자산	0	0	0	0	0
투자자산	162	163	164	164	4
기타비유동자산	6	7	7	7	7
기타금융업자산	0	0	0	0	0
자산총계	**397**	**475**	**543**	**623**	**716**
유동부채	**231**	**313**	**354**	**392**	**423**
단기차입금	201	212	212	212	212
매입채무	6	49	80	109	132
유동성장기부채	10	37	37	37	37
기타유동부채	14	15	25	35	42
비유동부채	**34**	**18**	**19**	**21**	**22**
사채	29	12	12	12	12
장기차입금	2	0	0	0	0
장기금융부채	0	3	3	3	3
기타비유동부채	3	2	4	5	7
기타금융업부채	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
부채총계	**265**	**331**	**373**	**413**	**445**
지배주주지분	132	144	170	210	271
자본금	11	11	11	11	11
자본잉여금	38	44	44	44	44
자본조정 등	-13	-12	-12	-12	-12
기타포괄이익누계액	12	12	12	12	12
이익잉여금	84	89	114	155	216
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
자본총계	**132**	**144**	**170**	**210**	**271**

(단위: 십억원)

현금흐름표	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동으로인한현금흐름	**-15**	**-24**	**41**	**77**	**42**
당기순이익	-5	5	28	43	63
유형자산 상각비	5	5	4	4	3
무형자산 상각비	0	0	0	0	0
외환손익	0	1	0	0	0
운전자본의 감소(증가)	-25	-37	8	30	-25
기타	10	2	0	0	0
투자활동으로인한현금흐름	**-14**	**1**	**-1**	**-1**	**177**
투자자산의 감소(증가)	2	0	-1	-1	161
유형자산의 감소	0	0	0	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-13	-3	0	0	0
기타	-4	5	0	0	16
재무활동으로인한현금흐름	**25**	**26**	**0**	**0**	**-1**
차입금의 증가(감소)	66	10	3	3	2
사채의증가(감소)	22	-17	0	0	0
자본의 증가	4	7	0	0	0
배당금	-2	-2	-3	-3	-3
기타	-65	28	0	0	0
기타현금흐름	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
현금의증가(감소)	**-3**	**4**	**41**	**76**	**219**
기초현금	8	5	9	49	126
기말현금	5	9	49	126	344

(단위: 원, 배, %)

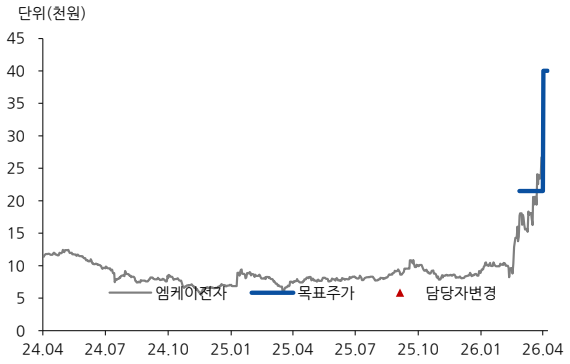
주요투자지표	2024	2025	2026F	2027F	2028F
EPS(당기순이익 기준)	-224	245	1,194	1,801	2,633
EPS(지배순이익 기준)	-224	245	1,194	1,801	2,633
BPS(자본총계 기준)	5,966	6,375	7,060	8,746	11,264
BPS(지배지분 기준)	5,966	6,375	7,060	8,746	11,264
DPS	100	120	120	120	120
P/E(당기순이익 기준)	N/A	34.3	22.4	14.9	10.2
P/E(지배순이익 기준)	N/A	34.3	22.4	14.9	10.2
P/B(자본총계 기준)	1.1	1.3	3.8	3.1	2.4
P/B(지배지분 기준)	1.1	1.3	3.8	3.1	2.4
EV/EBITDA(Reported)	25.2	20.2	18.8	12.1	6.7
배당수익률	1.5	1.4	0.4	0.4	0.4
성장성 (%)					
EPS(당기순이익 기준)	적전	흑전	387.6	50.8	46.2
EPS(지배순이익 기준)	적전	흑전	387.6	50.8	46.2
수익성 (%)					
ROE(당기순이익 기준)	-3.6	3.9	18.1	22.8	26.3
ROE(지배순이익 기준)	-3.6	3.9	18.1	22.8	26.3
ROA	-1.3	1.2	5.6	7.4	9.5
안정성 (%)					
부채비율	201.5	229.4	219.9	196.3	164.2
순차입금비율	171.7	169.3	121.3	63.1	순현금
이자보상배율	0.8	1.3	2.8	4.1	5.5

** K-IFRS 별도 기준*

▶ 투자의견 및 목표주가 추이

일 자	투자의견	목표주가	괴리율(%)	
			평균	최고/최저
2026.03.19	BUY	21,500	-8.02	25.12
2026.04.23	BUY	40,000		

▶ 최근 2년간 엠케이전자 주가 및 목표주가



▶ Compliance Notice

- 동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 언급된 종목의 지분율 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성) 발행과 관련하여 지난 6개월간 주간사로 참여하지 않았습니다.
- 조사분석 담당자 및 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 자료작성자 김종배의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

▶ 투자의견 분류

▶ 업종 투자의견 분류 현대차증권의 업종투자의견은 3등급으로 구분되며 향후 6개월간 업종 펀더멘털과 업종주가의 전망을 의미함.

- OVERWEIGHT : 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대
- NEUTRAL : 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음
- UNDERWEIGHT : 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대

▶ 현대차증권의 종목투자의견은 3등급으로 구분되며 향후 6개월간 추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 상대수익률을 의미함.

- BUY : 추천일 종가대비 초과수익률 +15%P 이상
- MARKETPERFORM(M.PERFORM) : 추천일 종가대비 초과수익률 -15%~+15%P 이내
- SELL : 추천일 종가대비 초과수익률 -15%P 이하

▶ 투자등급 통계 (2025.04.01~2026.03.31)

투자등급	건수	비율(%)
매수	181건	93.8%
보유	12건	6.2%
매도	0건	0%

- 본 조사자료는 투자자들에게 도움이 될 만한 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 당사의 사전 동의 없이 무단복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다.
- 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.